

機器利用技術講習会のご案内

【ホール効果測定装置】

地方独立法人大阪府立産業技術総合研究所では、所有している試験研究機器等を用いて、中小企業の皆様の新技术・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用頂くため、下記の要領で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

◆日 時：平成26年11月5日(水) 15:45~17:00

*当日、「半導体デバイス製造用スパッタ装置(10:15~14:00)」および「触針式膜厚測定装置(14:15~15:30)」の機器利用技術講習会も行っております。当講習会では、これらの機器利用技術講習会で作製した薄膜試料の膜厚を測定します。そして、膜厚測定を行った試料に対して電気特性評価のためのホール効果測定も行います。装置の理解をより深めるためにも「半導体デバイス製造用スパッタ装置」および「触針式膜厚測定装置」の機器利用技術講習会を当講習会とあわせて受講されることを強く推奨いたします。

◆場 所：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所(和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。

◆定 員：3名(1社1名まで)

※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

※ 受講には TRI カードが必要です。まだお持ちでない方は、申し込み方法をご連絡いたします。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 顧客サービス室 顧客サービス課

※ お申し込みはメール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2509) までお願いします。なお、メールでお申し込みを頂いた方には、当研究所の関連情報をご案内する「産技研ダイレクトメールニュース」を配信させていただきますので、ご了承下さい。

◆対象機器：ホール効果測定装置

本装置は、計測ユニット部、電磁石部、計測ユニット制御およびデータ解析部から構成され、薄膜試料や焼結体試料等の電気特性(比抵抗、キャリア密度、ホール移動度)を評価することができます。

測定方法の種類としてはファン・デア・ポウ法および四端子法に対応しています。また、測定プログラムにおいて測定項目の選択ができ、バイアス電流の自動設定、測定温度の設定等、種々の条件をあらかじめ入力しておき、付属の低温用および高温用温度制御部を用いて低温側は 20~280(K)の範囲を、高温側は真空中、室温~1073(K) [800(°C)]の範囲を、自動的に連続測定を行うことが可能です。いずれの測定に関しても、オーミック電極が必要となります。

本講習会は、初めてホール効果測定を行う方を対象に、機器の概要説明を行なった後、装置付属の標準試料等を用いて、試料のセットアップ方法および測定の実演を行います。

◆講習担当：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所

制御・電子材料科 筧 芳治、佐藤 和郎

・お問い合わせ先：顧客サービス課 (TEL：0725-51-2518)



機器型番：ResiTest8308
株式会社東陽テクニカ

